

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2021 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表

编号：2021-12-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	国投瑞银基金管理有限公司：苏超 融通基金管理有限公司：赵晨 3W fund 基金：杨文斌 深圳市明曜投资管理有限公司：曾昭雄、罗天艺 深圳市大华信安资产管理企业：齐靠民 丰岭资产：金斌 国金证券：邓小路 招商证券：王月 NikkoAM 日兴资产公司：杜毅忠 宏鼎财富：李宏明 明远睿达：周珺
时间	13：00~14:00
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介	一、公司简介

绍

公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。

受益于公司具前瞻性的战略布局，所选赛道玩家少，竞争格局好。公司上市以来收入持续增长，毛利率保持平稳，持续盈利。营收规模由 2010 年的 8.04 亿元稳步增长至 2020 年的 40.35 亿元，十年复合增长率为 17.51%；主营业务平均毛利率为 31.55%，因产品结构、经营模式的差异使公司具备一定的议价能力，毛利率处于同行较高水平；归母净利润由 2010 年 1.21 亿元增长至 2020 年 5.22 亿元，十年复合增长率为 15.70%。基于公司良好的经营状况，公司重视回馈股东，上市以来坚持每年现金分红，十年累计分红 7.09 亿元，十年平均占归母净利润比例为 32.6%。

当前 IC 封装基板全球缺货及下游需求的爆发式增长为公司带来了良好的发展机遇，未来公司的重点工作是推动广州兴科项目 IC 封装基板业务的投资扩产。

二、公司相关产能及规划介绍

PCB 业务：2020 年度，广州生产基地产能为 33.72 万平方米/年；宜兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4 万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为 1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分期建设投产。

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 HARBOR、广州科技。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已处于满产状态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成厂房建设，处于装修和产线安装调试阶段。

三、半导体测试板业务介绍

国内参与企业较少，公司 2020 年实现 5 亿元收入，在国内规模领先。台湾同行中华精测每年营收约 40~50 亿新台币，毛利率维持 55%以上，净利率 25%以上，附加值高。美国 Harbor 在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为一流半导体公司。公司向客户提供定制化服务，附加值较高，产品价格和毛利率均较高。半导体测试板是芯片测试环节的基础耗材，产品应用从晶圆测试到封装后芯片测试各环节，类型包括探针卡、负载板和老化板，全球约 200 亿元的市场空间，随着公司国内扩产的产能逐步释放，公司半导体测试板的市场份额将有望进一步增加。

四、IC 封装基板业务介绍

半导体行业从 2020 年开始表现出产销两旺的格局，收入、利润持续增长，产业链景气度高。公司从 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现预设经营目标。

2020 年全球 IC 封装基板行业规模 100 亿美金，增长 25%；Prismark 预测 2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元，复合增长率预期为 9.7%，届时 IC 封装基板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。2020 年内资载板厂规模为 4 亿元美金，全球市场占有率仅为 4%，而国内封测厂全球市场占有率为 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产是 IC 封装基板行业需求增长的保证，受益于芯片产业链的高景气，公司目前 IC 封装基板订单能见度高。

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家，行业赛道好，玩家少。三星认证的通过说明了我们的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可，且海外大客户的认证周期都是长达 2 年以上，因此预计未来 2~3 年新进入者仍无法成长到足以与公司比肩，产业链供需格局预期仍乐观。

五、公司与台企相比在 IC 封装基板产业的优劣介绍

从技术能力和客户资源方面看，因为起步晚等因素，与台企仍有一定差距；但对比台湾同行而言，公司有如下优势：（1）大陆市场需求大，国内芯片产业配套需求旺盛；（2）成本优势，国内生产成本、融资成本相对较低；（3）人均效率优势，国内人均产出、人均利润相对较高；（4）政策优势，国家芯片产业链国产化替代产业政策支持。

六、PCB 行业景气度介绍及其对公司的影响

未来行业表现仍将分化，国内行业增速会好于海外市场，技术升级的趋势仍将持续，高端产品需求会持续火爆，中低端市场会面临较大的压力。从产品结构看，呈现结构分化的增长趋势：高端产品如 HDI 板、多高层板的景气度较高，其供给滞后于需求，整体呈紧缺态势；中低端产品随着产品更新迭代、技术升级，需求会相对弱一些，近几年的行业扩产规模较大，整体是供给大于需求，略显疲软。从应用领域看，通信行业的增长情况取决于 5G 商用推动的进度；安防、工控、轨道交通等行业的增长相对平稳；计算机、医疗领域目前虽因疫情影响市场景气度较好，但从长期看表现平稳；汽车电子方面，总量没有大的增长，结构会从传统汽车转向新能源汽车。

全球 PCB 行业整体增速在 15%~20%之间，如果行业景气度下行，会对公司有一定影响，但影响不大，从历史业绩来看，不论行业景气度如何变化，公司 PCB 业务一直处于稳定增长态势；同时公司客户分散，集中度较低，不依赖单一客户单一行业，受行业周期性影响或单一客户影响较小，表现相对平稳，当然，不断提升自身能力是关键。

七、公司对 ABF 载板的规划

ABF 载板是公司未来的战略方向，也是公司在现有 BT 载板之外，未来计划重点投资的领域，目前正处于组建团队阶段，待团队组建完成即会启动投资扩产。

附件清单	无
日期	12 月 14 日